

关于举办全国高纯氮化铝粉体制备技术及应用交流大会的通知

随着半导体产业持续迭代升级，功率器件、先进封装不断发展，同时 AI 算力、CPO 共封装光学、高速光模块快速兴起，叠加新能源汽车高压平台对散热的需求持续提升，高纯氮化铝粉体作为氮化铝陶瓷基板、高导热填料的核心原料，在半导体封装、AI 服务器散热、CPO 光引擎、新能源汽车热管理等场景发挥着不可替代的关键作用，已成为新一代电子信息与新能源产业发展的重要支撑。

目前，我国高纯氮化铝粉体领域发展速度加快，但高端粉体在纯度控制、氧含量管控、批次稳定性、规模化制备等方面仍存在短板，高端产品供给仍存在缺口，关键环节“卡脖子”问题尚未完全化解，这在一定程度上制约了我国半导体、AI 算力光通信、新能源汽车等下游产业向高端化、先进化方向迈进。推动高纯氮化铝粉体的国产化替代，已成为全行业乃至社会广泛关注的焦点。

在此背景下，中国粉体网将举办全国高纯氮化铝粉体制备技术及应用交流大会。本次大会旨在为氮化铝粉体研发、生产与下游应用行业搭建专业交流平台，促进先进制备技术分享、行业供需信息互通与全产业链协同合作，助力高纯氮化铝粉体产业国产化进程稳步向前。

大会诚挚邀请行业专家、学者、技术人员及企业代表踊跃参会，同时也欢迎相关公司、企事业单位展示技术成果，共同推进产学研合作与产业融合发展。

时间：

2026 年 12 月 24 日

地点：

江苏扬州

主办单位：



会议主题：

1. 高纯氮化铝粉体国内外产业发展现状
2. 氮化铝粉体主流合成工艺进展
3. 高导热氮化铝陶瓷研究进展
4. 高纯氮化铝粉体纯度提升、降氧除杂关键技术与工艺
5. 氮化铝粉体粒度调控、球形化改性及分散处理技术
6. 氮化铝粉体批次稳定性控制与规模化量产工艺难点解析
7. 氮化铝粉体原料、反应气氛、装备对粉体综合性能的影响研究
8. 氮化铝粉体烧结活性调控及其对陶瓷基板性能的影响
9. 氮化铝复合粉体、填料表面改性技术与界面适配研究
10. 面向 AI 服务器散热的高导热氮化铝基板用粉体开发与应用
11. CPO 共封装光学光引擎用氮化铝陶瓷对粉体的性能需求
12. 高纯氮化铝粉体在功率半导体先进封装中的应用
13. 新能源汽车热管理用氮化铝材料开发及应用
14. 氮化铝粉体在热界面材料中的应用技术
15. 氮化铝粉体检测表征技术：氧含量、杂质、热导率、粒度精准测试方法
16. 高纯氮化铝粉体生产过程节能降耗、绿色制备工艺研究
17. 氮化铝粉体产业链关键装备国产化现状与发展

.....

大会赞助：

(赞助详细内容请联系会务组了解)

- 1 、协办赞助 (含 2*2.6m 展位、企业致辞、宣传片播放、企业报告、资料入袋等)
- 2 、晚宴赞助 (含 2*2.6m 展位、宣传片展示、晚宴致辞、主持人口播广告 等)
- 3、其它赞助 (会 2*2.6m 议礼品、资料袋、签到处双侧、会场后方广告，茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等)
- 4、展位展示 (展示桌椅、2*2.6m 展位背景墙广告)

会议费用：

2800 元/人 注册费包括会务、资料、茶歇、餐食、茶歇、晚宴、等费用；

普通展位展示

费用：1.2 万元

服务内容：

- 1、标准展桌一套（配 2 把椅子）
- 2、企业喷绘背景墙广告 1 个
- 3、参会名额*2
- 4、线上企业宣传推文一篇

赞助展位展示

费用：3-20w 万元

- 1、标准展桌一套（配 2 把椅子）
- 2、企业喷绘背景墙广告 1 个
- 3、参会名额 2 - 6 人
- 4 线上企业宣传推文一篇

.....

详询会议经理

收款账户

户名	山东中粉电子商务有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司临沂分行
账号	37050182830100000331

会务组：

联系人：李经理

联系方式：15563675367（同微信）

